



# MSL FPGA INC 晶片參數

## ■ 芯片概述

MAX6639AEE+ 是来自MSL FPGA INC美时龙的一款双通道温度监控与 PWM 风扇控制芯片，采用QSOP-16 封装，适用于服务器、工控设备等场景的散热管理，支持I2C/SMBus 接口和自动风扇调速。以下是其关键信息：

## ■ 核心参数

工作电压：3V 至 3.6V（典型值）。

温度监测：2 路远程温度传感器输入，精度  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ （ $-40^{\circ}\text{C}$  至  $+125^{\circ}\text{C}$  范围）。

风扇控制：支持 1 路 PWM 输出，频率可调（1.4 kHz 或 25 kHz）。

## ■ 功能特性

警报功能：通过 SMBALERT 引脚触发超温或风扇故障中断。

低功耗：工作电流仅500  $\mu\text{A}$ ，支持关断模式。

## ■ 应用场景

服务器散热：监控 CPU/GPU 温度，动态调节风扇转速（如 AI 服务器散热模块）。

工业控制：用于 PLC 或通信设备的温度保护电路。